

新製品紹介 **Formex TCI**

(Thermal Conductivity Insulator)

「絶縁材の熱伝導率に依る回路およびICへの影響」

アダプターやコンバーター等には、密閉された狭いスペースにIC等の電子部品が組み込まれており、内部温度上昇に対する考慮が必要とされます。その際、使用される絶縁材に依って、内部温度上昇に違いを生じる場合が多々有ります。

以下は、弊社が実際に計測したデータです。

	一般的な絶縁材使用	Formex TCI 使用
A 温度範囲120°CのIC使用回路	121.9 °C	113.5 °C
B 温度範囲125°CのIC使用回路	123 °C	111.2 °C

一般的な絶縁材を使用した場合、

例 Aでは、温度範囲を超え、この絶縁材は温度設計要件を満たしません。

例 Bでは、ぎりぎりの範囲で使用する事になり、リスクを負います。

Formex TCI は、熱伝導率*が 1W/m.K で、熱移動に効果的ですので、上記のような案件には十分なマージンが取れ、安心です。

*熱伝導率:熱勾配に伴い、熱の移動のしやすさを規定する物理量。

W/m.K = ワット/メートル.ケルビン



国栄通商株式会社

03-6435-56794

資料 YM-1008 Rev. 3